

公司代码：600703

公司简称：三安光电

## 三安光电股份有限公司

### 2024 年年度报告摘要

## 第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司正在推进回购股份事项，尚未实施完毕，参与本次现金分红的股份数量和金额将在权益分派实施公告中明确。经公司董事会研究，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司股份回购专户内股票数量）为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本4,989,018,727股，以扣减回购股份170,997,817股（暂以截至2025年4月14日的回购股份数量计算，最终将以回购股份实施完成后的数据为准）后的股份4,818,020,910股为基数，按此计算共计派发现金红利总额为96,360,418.20元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为38.11%。剩余未分配利润结转下一年度。公司2024年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。

本预案需经股东大会批准后实施。

## 第二节 公司基本情况

### 1、公司简介

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所 | 三安光电 | 600703 | ST三安    |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
|----------|-------|
| 姓名       | 李雪炭   |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 联系地址 | 福建省厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号 |
| 电话   | 0592-5937117             |
| 传真   | 0592-5937117             |
| 电子信箱 | 600703@sanan-e.com       |

## 2、报告期公司主要业务简介

### 1、LED 行业

根据 TrendForce 数据，受主要市场需求低迷影响，2024 年全球 LED 照明市场产值同比下滑 4.2%至 560.58 亿美元，但在市场整体疲软背景下，仍存在智能照明、植物照明市场逆势增长的结构性机遇。展望 2025 年，由存量市场二次替换 LED 的需求，以及对高光效、智能照明产品的需求将拉动产值恢复增长。TrendForce 预计，2025 年全球 LED 照明市场规模将恢复正向增长至 566.26 亿美元，预估 2029 年市场规模将达到 639.03 亿美元，2024-2029 年年复合增长率为 2.7%。在终端照明市场需求疲软的背景下，LED 行业仍存在结构性机遇，Mini/Micro LED、车载照明、植物照明等高端细分市场存在广阔成长空间。

2024 年 Mini LED 在背光产品应用保持持续增长，直显领域市场也在起量。Mini LED 背光解决方案在电视、笔电、平板、显示器、车载显示等市场快速渗透，其中电视为主要增量市场，各大电视终端品牌厂商着力推广 Mini LED 背光电视，带动 Mini LED 背光市场规模开启高速成长模式。根据 Omdia 数据，2024 年，在中国品牌积极的市场策略以及中国“能效补贴”政策影响下，Mini LED 背光电视出货量翻倍增长，达到 620 万台，预计 2025 年出货量将达 930 万台，首次超过 OLED 电视的 750 万台，显示出其在高端显示领域的强劲竞争力。Mini LED 直显应用场景不断拓宽，包括 XR 虚拟影棚专用屏、影院屏和 LED 一体机（用于智慧教育、会议、医疗、指挥中心、展览展示、演播室等场所）等，渗透率随之走高。据洛图科技预计，2028 年 Mini LED 直显全球市场规模将达 33 亿美元，2024-2028 年的年复合增长率约为 40%，市场未来发展空间广阔。

2024 年 Micro LED 直显应用在一体机市场和家庭巨幕市场持续升温，并在 AR 眼镜、车载数字大灯领域持续有标志性产品落地，Micro LED 拥有巨大的应用前景。据 LEDinside 统计，2024 年已有 11 款新型 AR 眼镜采用了 Micro LED 技术。根据 TrendForce 预测，未来几年随着晶片垂直堆叠与色彩转换技术的成熟，Micro LED 微显示方案的渗透率或将持续提升，2030 年在 AR 市场渗透率有望达到 44%。根据 Omdia 预测，2024 年全球 Micro LED 出货不足 1 亿美元，但将在未来实现大幅度增长，至 2030 年全球 Micro LED 市场规模有望达到 44.4 亿美元。

2024 年汽车制造商面临市场竞争与成本下降的压力，积极利用自适应性头灯、Mini LED 尾灯、贯穿式尾灯、格栅灯/全宽前灯条、氛围灯、Mini LED 背光显示等高附加价值产品进行市场营销，带动车用 LED 市场需求稳定成长。根据 TrendForce 数据，2024 年车灯/车用 LED 市场分别达到 373.95 亿美元与 34.45 亿美元，皆高于车市出货表现。根据 CSA Research 数据，目前全球车用 LED 器件市场的 70%以上仍被 ams OSRAM、日亚、Lumileds 三大龙头企业占据，国产 LED 车灯产业链上中下游企业已逐步完善器件规格，加强模块化供应及灵活响应能力，国产替代将持续加

速。

此外，植物照明市场需求在粮食安全、城镇化和资源短缺、绿能产业链环保议题等背景下快速增长，在城市农业、园艺、花卉种植等领域得到广泛应用。TrendForce 最新数据显示，2024 年全球 LED 植物照明市场规模达 13.15 亿美元，同比增长 6.6%。

面对照明市场需求疲软等严峻挑战，我国加大政策调节力度，推出了一系列助力 LED 产业转型升级的政策。新版《产业结构调整指导目录（2024 年本）》于 2024 年 2 月 1 日起正式施行，明确提出了鼓励、限制和淘汰三类产品，其中普通照明白炽灯为限制类产品，部分含汞的荧光灯和高压汞灯为淘汰类产品，鼓励使用和发展半导体照明产业链相关产品及其生产制造设备的应用，通过产业结构调整目录加大 LED 绿色照明产品的推广力度，并为 LED 照明企业参与跨界产品的研发、制造提供依据。2024 年 3 月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，国家发展改革委、住建部、文旅部等 6 部门联合印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，其中涉及文旅照明设备、绿色节能产品更新等相关内容，明确要推动舞台显示设备更新、影院 LED 屏放映系统更新以及 4K 超高清设备建设，上述政策为 LED 微显示技术进步和产业化应用提供了机遇。

## 2、 集成电路行业

人工智能、消费电子拉动下游需求回暖，全球半导体市场正持续复苏。根据 WSTS 数据，2024 年全球半导体销售额达 6,276 亿美元，同比增长 19.1%。但在下游市场需求复苏的背景下，中国仍为集成电路进口大国。根据海关总署统计，2024 年中国集成电路进口金额达 3,856 亿美元，而中国集成电路出口金额仅为 1,595 亿美元，贸易逆差显著，集成电路国产化率亟待提升。

2024 年以来，多部门陆续印发了规范、引导、鼓励、规划集成电路行业的发展政策，内容涉及集成电路技术规范、集成电路集群发展支持、集成电路人才培养支持等内容。其中，2024 年 1 月，工业和信息化部等七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出把握全球科技创新和产业发展趋势，重点推进人形机器人、高级别智能网联汽车、元宇宙入口等高潜能未来产业，深入实施产业基础再造工程，补齐基础元器件、基础零部件、基础材料、基础工艺和基础软件等短板，夯实未来产业发展根基。在国家政策的大力支持下，国产集成电路厂商发展机遇凸显

### （1） 电力电子

电力电子器件又称为功率器件，主要应用于变频、变压等领域。第三代半导体功率器件主要以碳化硅和氮化镓为代表，具备高频、高效、高功率、耐高压、耐高温、抗辐射能力强等优越性能。我国“十四五”规划已将碳化硅半导体纳入重点支持领域，随着国家半导体产业战略的实施，以碳化硅为代表的宽禁带半导体行业已成为面向经济主战场的战略性行业。

#### ① 碳化硅

碳化硅功率器件凭借禁带宽度大、饱和电子漂移速率高、导热率高、击穿电场强度高等优势，被广泛应用于新能源汽车、充电桩、光伏储能、数据中心服务器等应用领域。根据 Yole 数据，2023 年全球碳化硅功率器件市场规模为 27.46 亿美元，预计 2029 年有望达到 98.73 亿美元，2023-2029

年的年复合增长率约 24%。

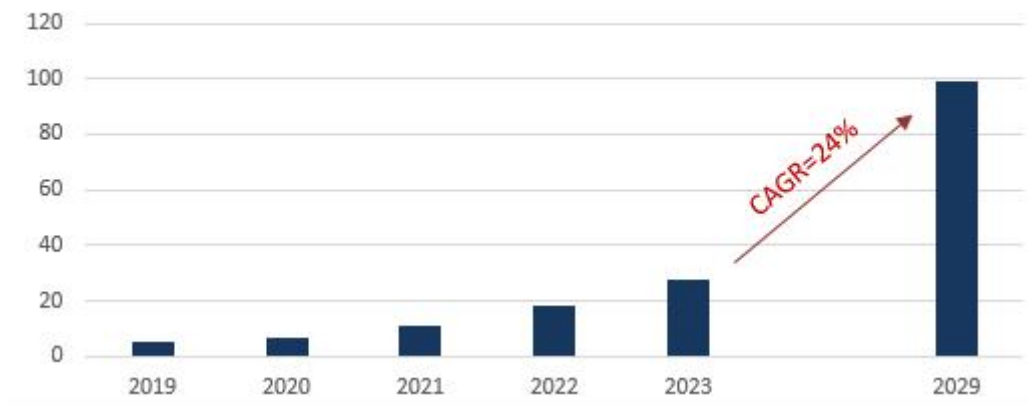
**新能源汽车市场：**碳化硅器件被广泛应用于新能源汽车的电机控制器、车载充电机（OBC）、车载 DC-DC 变换器、电池管理系统等领域。根据行家说 Research 统计数据，2023 年全球碳化硅车型（指主驱搭载碳化硅功率模块的车型）销量约为 280 万辆，预计 2024 年、2025 年将分别增长至 338 万辆、450 万辆。伴随产业链降本及车企对高性能配置的追求，2024 年主驱碳化硅模块已下沉至 10-15 万元价格段车型，在新能源汽车市场的下沉渗透将持续拉动全球碳化硅市场规模的增长。

**光伏储能市场：**碳化硅在光伏逆变器及储能变流器中能够提升系统效率、简化拓扑结构，2024 年逆变器厂商均在积极将碳化硅器件导入应用，且从早期的微逆逐步开始应用于组串式光伏系统，甚至兆瓦级的集中式光伏系统中。根据国家能源局数据，2024 年我国太阳能发电装机容量达到 88,666 万千瓦，同比增长 45.2%，我国已建成投运的新型储能项目累计装机规模达 7376 万千瓦 / 1.68 亿千瓦时，同比增长超过 130%。未来，光伏储能产业的稳健增长及碳化硅器件应用的持续渗透将继续为碳化硅市场增长提供坚实助力。

**充电桩市场：**公共直流充电桩向更大功率、更高功率密度、更智能化等方向快速演进，要求电源模块的功率等级和功率密度不断提升，从 20kW/30kW 逐步提高至 40kW/50kW 及以上，这使得充电桩领域对 SiC 功率器件的需求也在快速提升。根据国家能源局数据，截至 2024 年 12 月底，我国电动汽车充电设施总数达到 1281.8 万台，同比增长 49.1%，未来充电设施的加速建设将快速拉动碳化硅器件需求。

**PFC 电源市场：**碳化硅、氮化镓在 PFC 电源上的应用能够显著提升其电源效率，并减小体积，因此已开始逐步在 PFC 电源领域替代原有的硅基功率器件。特别是在服务器电源的 PFC 中，碳化硅器件可以提升服务器电源的功率密度和效率，缩小数据中心的体积，降低数据中心的建设成本。目前已有台达、光宝、欧陆通等众多电源模块厂商推出应用碳化硅器件的服务器电源产品，预计未来 AI 技术的不断演进和数据算力需求的持续提升，有望拉动服务器电源用碳化硅市场持续增长。

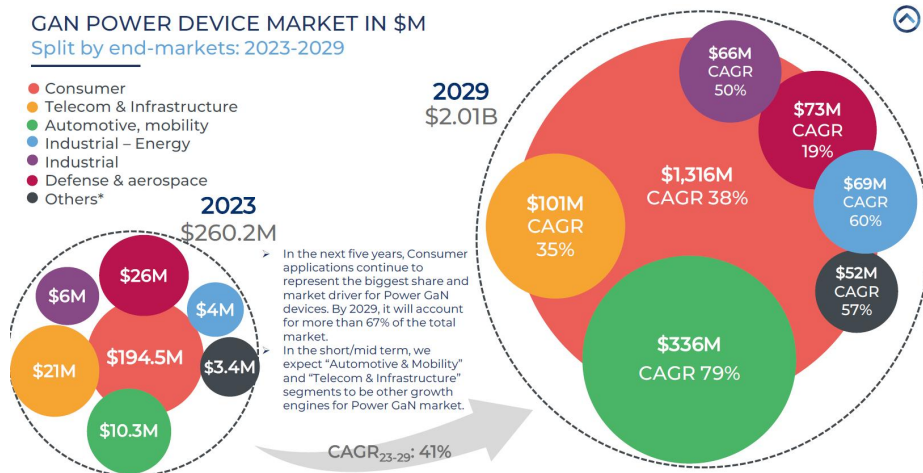
全球碳化硅功率器件市场规模预测（单位：亿美元）



同时，碳化硅材料也在 AR 眼镜、热沉散热等新兴应用领域呈现出高成长性。在 AR 眼镜领域，碳化硅材料可以通过高折射率和高热导率两大核心特性，系统性解决 AR 眼镜的视场角窄、彩虹伪影及散热难题。根据维深信息 wellsenn XR 数据，2024 年全球 AR 眼镜销量为 50 万台，销量同比基本持平，未来，伴随 AI 技术的快速发展以及智能眼镜硬件的不断升级，AI+AR 智能眼镜将进入高速发展期，2030 年全球 AI 眼镜出货量有望增长至 8000 万副。根据行家说 Research 数据，按照一片 8 吋片可供 4 副 AR 眼镜折算，AR 眼镜市场有望为半绝缘碳化硅衬底提供广阔增量空间。在热沉散热领域，碳化硅晶片的热膨胀系数、热导率参数优于氮化铝陶瓷、氧化铍陶瓷、碳化硅陶瓷等传统热沉材料，因此能更有效的将热量散出，同时避免热应力损坏芯片，在封装基板、5G 基站、激光电视、激光切割等应用场景具备广阔市场。

## ② 氮化镓

氮化镓器件作为电力电子领域的核心技术之一，可以实现更高的系统效率、更少的功率损耗和更小的模块体积，广泛应用于低功率消费电子市场，并逐步向新能源汽车、高功率数据中心、通信电源等应用场景渗透。根据 Yole 数据，全球氮化镓功率器件市场规模将从 2023 年的 2.6 亿美元增长到 2029 年的 20.1 亿美元，年复合增长率预计将达 41%。



## (2) 射频前端

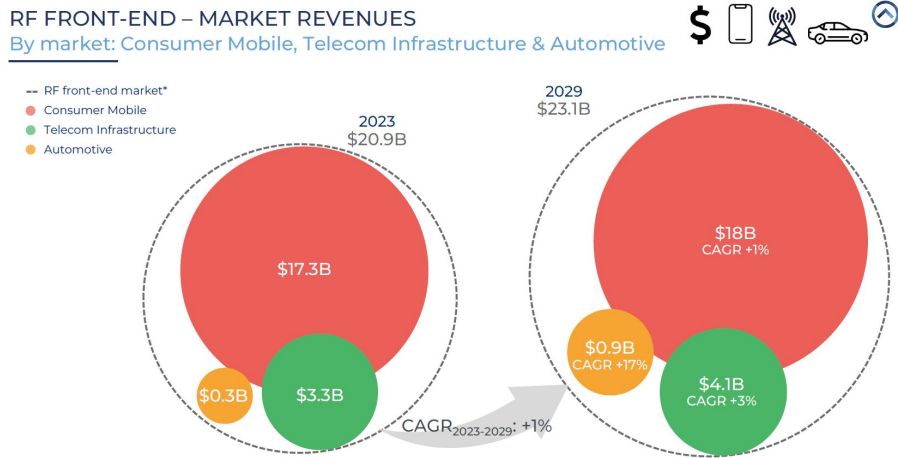
射频前端由功率放大器、低噪声放大器、滤波器、射频开关、天线调谐器等器件组成，其作用主要为无线电磁波信号的发射和接收，将数字信号转换成射频信号，是无线通信系统的核心组件。目前无线通信市场已全面迈入 5G 时代，未来 6G、低轨卫星等移动通信技术的蓬勃发展将继续拓宽射频前端的应用场景与空间。根据 Yole 预测，全球射频前端市场规模将由 2023 年的 209 亿美元增长至 2029 年的 231 亿美元，至 2029 年，手机等移动终端、通信基站、汽车三大应用领域将分别贡献约 180 亿美元、41 亿美元、9 亿美元的市场。

**手机等移动终端市场：**根据 Canalys 的数据，全球智能手机 2024 年第四季度出货量同比增长 3%，达到 3.3 亿部，已连续五季度实现同比增长，2024 年全球智能手机出货量总计 12.2 亿部，同比增长 7%，全球智能手机行业已逐步回暖，拉动射频前端需求有所反弹，同时物联网、智能家居等领域对射频前端模组的需求也在持续增长。5G 通信技术渗透率持续提升，推动射频前端模组

市场价量齐升，叠加供应链国产化替代浪潮加速，国内射频前端厂商发展空间广阔。

**通信基站市场：**根据工信部数据，截至 2024 年 10 月底，我国 5G 基站建设总数达 414.1 万个，相较上年末净增加 76.4 万个，我国已经提前完成了“十四五”期间关于 5G 基础设施建设的发展目标，并有序推进 5G 向 5G-A 升级演进。未来，大规模 MIMO 和 RHH 技术的引入、6GHz 以及更高频段的开发、小型基站和专网的应用铺设等将刺激下一代通信设备的迭代，主导通信基站用射频前端器件增长。

**汽车市场：**5G TCU 技术和先进的射频前端模组可以为车辆提供更高的带宽、更低的时延并支持更广泛的频段，以响应智能化车辆对于数据和无线通信的需求，在电动车智能化的趋势推动下，车规级无线通信网络将贡献新的增长空间。



### (3) 光技术

光芯片是实现光电信号转换的基础元件，按功能可以分为激光器芯片（VCSEL、FP、DFB 和 EML 等）和探测器芯片（PD 和 APD 等），在光通信领域得到重要应用。光芯片作为光模块的核心部件，性能直接决定光通信系统的传输效率，光芯片价值占比随光模块速率的提升而上升。

光纤宽带、5G、数据中心、云计算设施、智能计算中心等设施建设持续推进，全球数据流量急剧增加，大规模的数据处理需求，刺激光模块及其配套芯片持续迭代发展。在 AI、元宇宙等浪潮的推动下，网络传输速度将大幅提升，400G 以上高速率光模块需求加速释放，驱动光芯片市场增长。根据 LightCounting 数据，全球光芯片市场规模有望从 2024 年的 35 亿美元增长至 2030 年的超 110 亿美元，年复合增长率约 17%。

激光雷达通过发射激光束探测目标物体的三维空间信息，已成为智能感知领域的核心传感器，根据 Yole 预测，全球汽车激光雷达市场将从 2023 年的 5.38 亿美元增长至 2029 年的 36.32 亿美元，年复合增长率预计将高达 38%。除汽车智能驾驶之外，激光雷达的应用也逐渐拓展至机器人、工业自动化等领域，并正经历从高端市场向大众市场渗透的关键转折期，未来激光雷达有望持续高速发展。

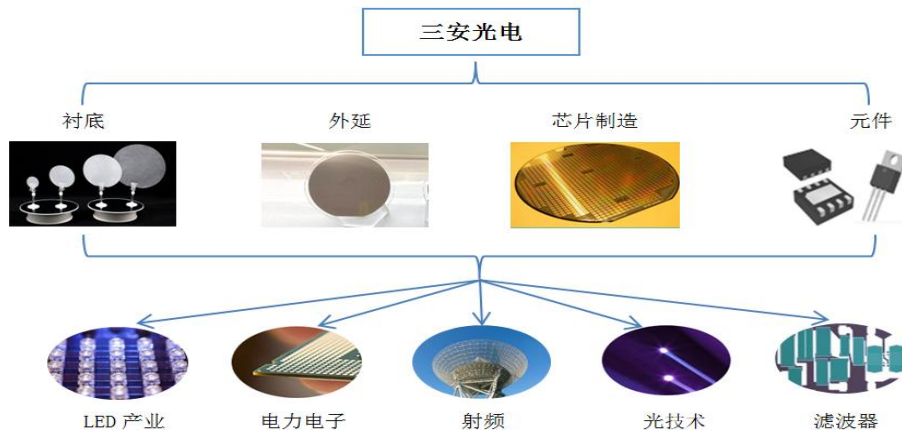
#### (一) 公司主要业务

公司主要从事化合物半导体材料与器件的研发、生产和销售，以氮化镓、砷化镓、碳化硅、

磷化铟、氮化铝、蓝宝石等化合物半导体新材料所涉及的外延片、芯片为核心主业，主要产品、材料、产品系列及相关应用领域如下表：

| 产品范围    | 材料             | 主要产品         | 产品系列                            | 主要用途                                                                 |
|---------|----------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| LED外延芯片 | GaAs、GaN       | LED外延片       | 红色、黄色、橙色、黄绿色<br>紫色、蓝色、绿色        | LED产业链的上游产品，用于生产LED芯片。                                               |
|         |                | LED芯片        | 红色、黄色、橙色、黄绿色<br>紫色、蓝色、绿色        | 提供给LED封装厂商用于生产LED终端产品，可广泛应用于照明、显示、背光、农业、医疗、AI/AR眼镜等众多领域。             |
|         |                |              |                                 |                                                                      |
| LED应用产品 | GaAs、GaN       | LED车灯        | 前灯、后尾灯、室内灯、标志灯、氛围灯              | LED产业下游产品，提供给汽车主机厂进行整机组装。                                            |
| 集成电路芯片  | GaAs、GaN、LT/LN | 射频芯片         | HBT、pHEMT、HEMT                  | 终端、基站、无线局域网络、智能穿戴、无人驾驶、机器人、卫星通信等领域。                                  |
|         |                | 滤波器芯片        | SAW、TC-SAW                      | 4G、5G无线通信、自动驾驶、物联网、卫星通信等领域。                                          |
|         | SiC、GaN        | 电力电子芯片       | 碳化硅MOSFET、碳化硅二极管、碳化硅衬底/外延、硅基氮化镓 | 新能源汽车、充电桩、光伏储能、通信基站、数据中心、不间断电源、工业自动化、家用电器、AI/AR眼镜等领域。                |
|         | GaAs、InP       | 光通讯芯片、非光通讯芯片 | PD、VCSEL、DFB                    | 光通讯类：主要适用于5G网络、接入网、数据中心以及AI应用场景；非光通讯类：主要用于3D识别、汽车无人驾驶、激光美容器、工业加热等领域。 |

(二) 公司产业布局图



报告期内，本公司主营业务范围未发生重大变化。

### (三) 主要经营模式

公司自设立以来，一直坚持“技术+人才”的科技成果产业化模式，以技术创新为手段，以科技成果产业化为目标，不断开拓新业务，壮大实力。

采购模式主要采用“直接采购+寄售采购”的方式，大部分原材料由公司采购中心根据需求制定采购计划，向供应商直接下达订单，并签订采购合同；另有少量原材料由供应商存放在公司仓库，公司每月根据实际使用量，与供应商对账后结算。

生产模式是以“订单+市场预测”为基础，结合库存按计划组织生产。公司销售部门根据客户订单和市场预测信息传递给战略运营中心，战略运营中心结合公司库存情况制定生产计划，并传递给生产管理部门，生产管理部门按照生产计划组织生产。

销售模式主要采取直销方式，下游客户主要为 LED 封装企业、应用厂商及化合物半导体集成电路设计企业等。

### 3、 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

|                                 | 2024年             | 2023年             | 本年比上年<br>增减(%) | 2022年             |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 总资产                             | 59,052,883,378.53 | 57,675,135,347.94 | 2.39           | 58,389,605,253.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产                   | 36,868,570,744.34 | 38,303,349,738.35 | -3.75          | 37,946,383,304.72 |
| 营业收入                            | 16,105,827,496.67 | 14,052,751,956.74 | 14.61          | 13,222,316,118.09 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 11,497,969,844.33 | 10,202,739,061.54 | 12.69          | 9,816,835,214.01  |
| 归属于上市公司股东的净利润                   | 252,846,286.50    | 366,559,956.36    | -31.02         | 685,111,367.50    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润          | -511,016,467.08   | -1,088,361,702.16 | 53.05          | -309,992,854.11   |
| 经营活动产生的现金流量净额                   | 2,616,784,618.19  | 3,977,380,864.98  | -34.21         | 799,976,259.04    |
| 加权平均净资产收益率(%)                   | 0.68              | 0.97              | 减少0.29个百分点     | 2.22              |
| 基本每股收益(元/股)                     | 0.05              | 0.07              | -28.57         | 0.15              |
| 稀释每股收益(元/股)                     | 0.05              | 0.07              | -28.57         | 0.15              |

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 3,557,053,177.25 | 4,122,406,680.28 | 4,175,436,091.97 | 4,250,931,547.17   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 118,744,740.73   | 65,553,539.87    | 62,870,228.41    | 5,677,777.49       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -32,272,680.03   | -256,103,507.59  | -62,806,225.97   | -159,834,053.49    |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 540,987,740.39   | 994,793,685.58   | 660,892,374.99   | 420,110,817.23     |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

### 4、 股东情况

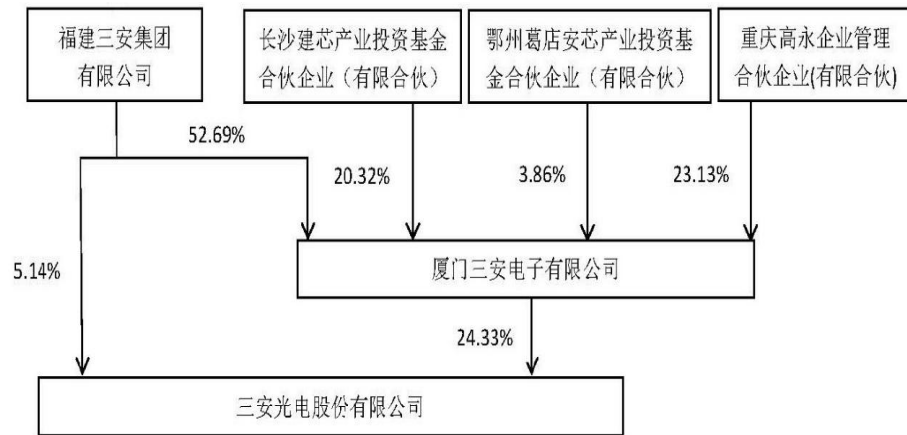
#### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

| 截至报告期末普通股股东总数（户）                                    |             |                                                                                       |           |                          | 405,230        |             |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）                             |             |                                                                                       |           |                          | 383,392        |             |             |
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）                              |             |                                                                                       |           |                          |                |             |             |
| 股东名称<br>（全称）                                        | 报告期内增<br>减  | 期末持股数量                                                                                | 比例<br>（%） | 持有有<br>限售条<br>件的股<br>份数量 | 质押、标记或冻结情<br>况 |             | 股东<br>性质    |
|                                                     |             |                                                                                       |           |                          | 股份<br>状态       | 数量          |             |
| 厦门三安电子有限公司                                          | 0           | 1,213,823,341                                                                         | 24.33     | 0                        | 质押             | 605,600,000 | 境内非国<br>有法人 |
| 湖南臻泰股权投资管理<br>合伙企业（有限合伙）<br>—长沙先导高芯投资合<br>伙企业（有限合伙） | 0           | 286,368,843                                                                           | 5.74      | 0                        | 无              | 0           | 其他          |
| 福建三安集团有限公司                                          | 0           | 256,633,542                                                                           | 5.14      | 0                        | 质押             | 112,200,000 | 境内非国<br>有法人 |
| 三安光电股份有限公司<br>回购专用证券账户                              | 130,134,874 | 161,615,617                                                                           | 3.24      | 0                        | 无              | 0           | 其他          |
| 三安光电股份有限公司<br>—第五期员工持股计划                            | 0           | 138,467,713                                                                           | 2.78      | 0                        | 无              | 0           | 其他          |
| 珠海格力电器股份有限<br>公司                                    | 0           | 114,547,537                                                                           | 2.30      | 0                        | 无              | 0           | 其他          |
| 国家集成电路产业投资<br>基金股份有限公司                              | 0           | 113,727,232                                                                           | 2.28      | 0                        | 无              | 0           | 国有法人        |
| 长沙福芯产业投资合伙<br>企业（有限合伙）                              | 0           | 96,774,193                                                                            | 1.94      | 0                        | 无              | 0           | 其他          |
| 三安光电股份有限公司<br>—第三期员工持股计划                            | 0           | 76,017,479                                                                            | 1.52      | 0                        | 无              | 0           | 其他          |
| 香港中央结算有限公司                                          | 5,998,206   | 75,802,172                                                                            | 1.52      | 0                        | 无              | 0           | 其他          |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                    |             | 公司前十名股东中，福建三安集团有限公司是厦门三安电子有限公司的控股股东，公司未知其余股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |           |                          |                |             |             |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                                 |             | 无                                                                                     |           |                          |                |             |             |

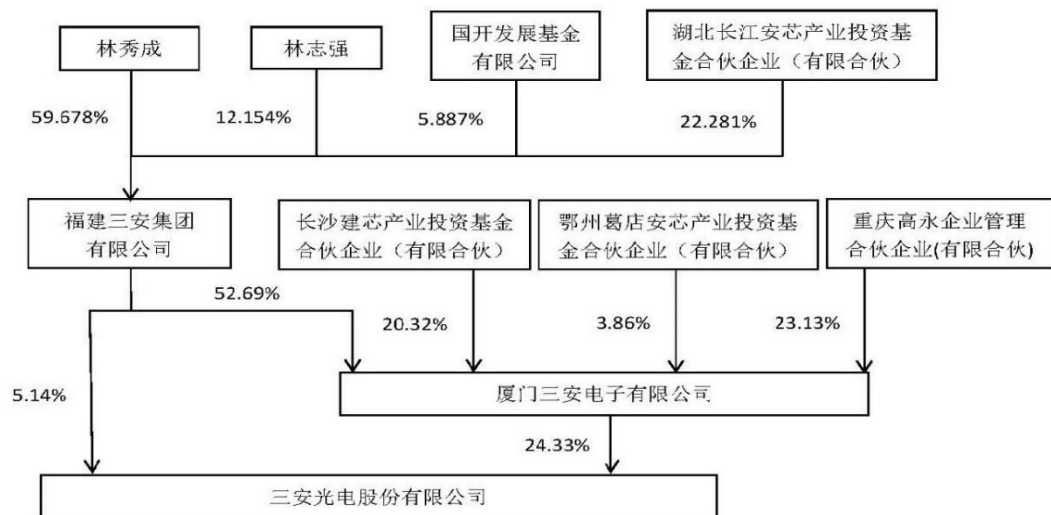
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

#### 5、公司债券情况

□适用 √不适用

### 第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现销售收入 161.06 亿元，同比增长 14.61%；归属于母公司股东的净利润 2.53 亿元，同比下降 31.02%。截止报告期末，公司资产总额 590.53 亿元，同比增长 2.39%；归属于上市公司股东的净资产 368.69 亿元，同比下降 3.75%。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

☐适用 ☒不适用